

会社名 **サムコ 株式会社**

上場取引所 JASDAQ

コード番号 6387

本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.samco.co.jp>)

本社所在地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地

代表者 代表取締役社長 辻 理

問合せ先責任者 管理本部長兼経理部長 田井 彰

中間決算取締役会開催日 平成 18 年 3 月 16 日

中間配当支払日 平成 - 年 - 月 - 日

TEL (075) 621 - 7841

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 18 年 1 月中間期の業績 (平成 17 年 8 月 1 日 ~ 平成 18 年 1 月 31 日)

(1) 経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 1 月中間期	1,446	(6.2)	85	(33.3)	89	(20.4)
17 年 1 月中間期	1,541	(8.8)	127	(36.3)	112	(35.6)
17 年 7 月期	3,090		258		263	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当 たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円 銭	円 銭
18 年 1 月中間期	50	(28.8)	10 31	
17 年 1 月中間期	70	(34.0)	14 48	
17 年 7 月期	166		33 96	

- (注) 1. 持分法投資損益 18 年 1 月中間期 百万円 17 年 1 月中間期 百万円 17 年 7 月期 百万円
 2. 期中平均株式数 18 年 1 月中間期 4,889,140 株 17 年 1 月中間期 4,889,140 株 17 年 7 月期 4,889,140 株
 3. 会計処理の方法の変更 無
 4. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率
 5. 期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
18 年 1 月中間期	0 00	
17 年 1 月中間期	0 00	
17 年 7 月期		12 50

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 1 月中間期	6,911	5,037	72.9	1,030 26
17 年 1 月中間期	6,939	4,957	71.4	1,014 02
17 年 7 月期	6,830	5,046	73.9	1,032 11

- (注) 1. 期末発行済株式数 18 年 1 月中間期 4,889,140 株 17 年 1 月中間期 4,889,140 株 17 年 7 月期 4,889,140 株
 2. 期末自己株式数 18 年 1 月中間期 1,750 株 17 年 1 月中間期 1,750 株 17 年 7 月期 1,750 株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18 年 1 月中間期	206	23	128	770
17 年 1 月中間期	21	24	145	966
17 年 7 月期	168	47	168	1,122

2. 18 年 7 月期の業績予想 (平成 17 年 8 月 1 日 ~ 平成 18 年 7 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中間	期末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	3,520	430	260	12 50	12 50	

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 53 円 18 銭

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 7 ページを参照してください。

添付書類

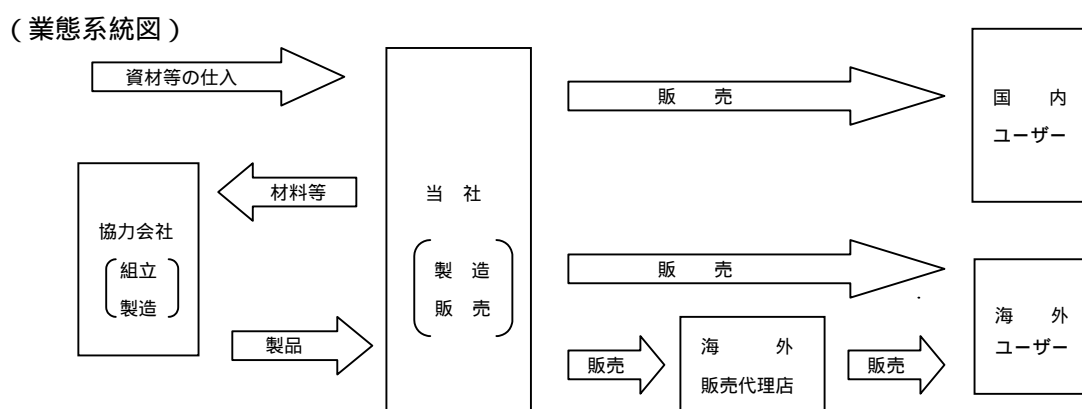
1. 企業集団の状況

当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。当社の基本となる薄膜形成技術はCVD法（Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法）によるもので、当社の各装置においては、ナノテクノロジーと言われる10nm～100μmまでの成膜や加工が可能であります。（nm = ナノメートル：10億分の1メートル μm = マイクロメートル：1百万分の1メートル）

当社の装置は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

(CVD装置)

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置（LS = Liquid Source）に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性の良い成膜が可能です。

(エッチング装置)

各種半導体の基板の膜をはじめ微細加工に必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社はICP（Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ）を利用したエッチングに特徴があり、高速でかつ選択比に優れた加工が可能です。

(洗浄装置)

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求される3次元実装などに必要とされております。

(その他装置)

上記装置には含まれない特別な装置であります。

(その他)

部品、保守メンテナンスなどがあります。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は『薄膜技術で世界の産業科学に貢献する』ことを経営理念とし、社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

(3) 投資単位の引き下げについて

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。特に1単元株式数の見直しによる株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために実行すべき課題として認識しております。当社では、既に、平成16年12月1日付をもって1単元の株式の数を1,000株から100株に変更し、株主数は現在増加傾向にあります。更なる引下げにつきましては、今後の動向を見ながら慎重に検討し対処いたしたいと考えております。

(4) 目標とする経営指標

当社は中期的にも収益力の高い企業であり続けようと考えております。そのため売上高総利益率50%を確保し売上高の拡大により売上高経常利益率20%台への向上、維持を目指します。売上高の拡大のためには、研究開発用途向け装置に加えて生産用途向け装置の拡販に努めるとともに、海外売上高比率を現在の10%台から30%台へ上げる方針です。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は化合物半導体を中心としたオプトエレクトロニクス分野に経営資源を集中しながら、中期的には次の3点について戦略を展開してまいります。第一は、既に各種バックライトとして実用化の盛んな白色および青色LED(Light Emitting Diode = 発光ダイオード)や次世代大容量光ディスク用途向けに注目されている青色LD(Laser Diode = 半導体レーザー)の量産化への対応及び各種センサーやチップが日々開発されて拡大している各種電子部品分野等への対応のため、本格的な生産用装置を開発し、メンテナンスを含めた販売力を強化していくことであります。第二は、これらの分野も含めて、生産用と研究開発用が同時進行で拡大すると予想されている中国市場への積極展開であります。平成16年11月に上海事務所を開設し、販売力の強化とアフターサービスの向上を図っており、順調に市場開拓が進んでおります。また、インド市場を始め常に新たな海外市場の発掘に努めております。第三は、CVD装置、エッチング装置、洗浄装置といった当社の三大製品群に匹敵するIT分野の第四の柱を確立することです。当社は、米国シリコンバレー、英国ケンブリッジとの3極体制で行っている研究開発と国内の大学や各種クラスターとの共同研究を行っておりますが、これらの中から、薄膜事業に関連する新事業、新分野をいち早く立ち上げ、当社の中期的な事業拡大に寄与する事業に成長させたいと考えております。

(6) 対処すべき課題

現状の認識について

現状、デジタル家電関連の設備投資にも回復感が見られる中、白色および青色LED、LDが牽引役となるオプトエレクトロニクス市場では、今後自動車関連部品や一般照明用に巨大市場の出現が予想されます。また、三次元実装などで高性能化を進める電子部品分野での需要の拡大やITバブル崩壊後通信分野での需要回復が期待されます。これまで当社装置の中心的用途となっていた研究開発用途に加え生産用途としての生産用装置の開発と販売・メンテナンス体制の確立を急ぐことが重要と考えております。また、これらの展開はグローバル化しており、特に中国市場は重点市場として上海事務所における拡販が重要であると認識しております。

当面の対処すべき課題の内容

当面の課題は量産用CVD装置と独口パート・ボッシュ社より技術導入いたしました「ボッシュプロセス」を取り入れたICPドライエッチング装置の性能向上と販売力強化であります。また、オプトエ

レクトロニクス分野の LED、LD 生産用途向けの新型 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)装置の商品化も重点的課題であります。そのためには、経営資源の集中とより一層の人材育成が必要であると考えております。

対処方針

生産用装置の販売力強化はスケジュール通り実行中であります。適材適所の人材については、スキル保有人材を中心に国内外の各方面に広く門戸を開放し、中途採用を強化するとともに、独自の社内研修システムを確立していく方針であります。

具体的な取組み状況等

当社は、生産機分野への本格的参入による新たな成長に向けての決意を社内外に表明し、新しい企業イメージをアピールするため、平成 16 年 12 月 1 日付で旧商号「株式会社サムコインターナショナル研究所」から新商号「サムコ 株式会社」へ社名変更いたしました。平成 17 年 2 月 1 日には組織変更を行い、「生産機事業部」を新設いたしました。専任部署として開発から設計・営業・製造・納入までの全工程を一元的に統括管理し、新市場の開拓、顧客ニーズへの対応強化による拡販に注力しており、生産用途向けに大型装置の受注が増加傾向にあります。また、重点部門に絞った中途採用のみならず、海外の専門家ともアドバイザー契約を結んでおります。事業拡大のための業務提携についても検討中であります。ただし、先方の技術力の評価と当社の業容との相乗効果を考慮しながら決定していく方針であります。

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおります。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

a. 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

会社の機関の内容

当社の株主総会は、設立時からの 7 月決算を貫くことにより、参加しやすく開かれた総会を目指しており、また取締役会は、意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月 1 回以上の開催を定例化し、法令で定められた事項およびその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況の管理監督がなされております。当社の取締役は 6 名ですが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しながら、開かれた運営を基本としております。当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役は 4 名のうち山田史郎氏が常勤監査役で残り 3 名は全員社外監査役であり、取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェックし、公正な意見が発言できる仕組みを作り上げております。

内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況

内部統制については、内部監査室が年間計画に基づく業務監査を実施して、内部牽制の実効性を高めております。内部監査室は、業務活動の全般に関し、その妥当性や有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに経営者に速やかに報告いたしております。リスク管理については、管理本部内の総務部が窓口となって各部門から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監視、リスク・チェックの強化に取り組んでおります。顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面等についての公正かつ適切な助言、指導を受けております。今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

内部監査室は、監査役と連携して社内各部門の業務執行状況について、定期的な業務監査を行っております。監査役は取締役会に出席するほか、定例的に開催される重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。会計監査は、あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

指定社員 業務執行社員 米林 彰 あずさ監査法人

指定社員 業務執行社員 宮林 利朗 あずさ監査法人

継続監査年数については、2 名共に 7 年以内であるため、記載を省略しております。

また、監査業務に係る補助者は、公認会計士 4 名、会計士補 4 名であります。

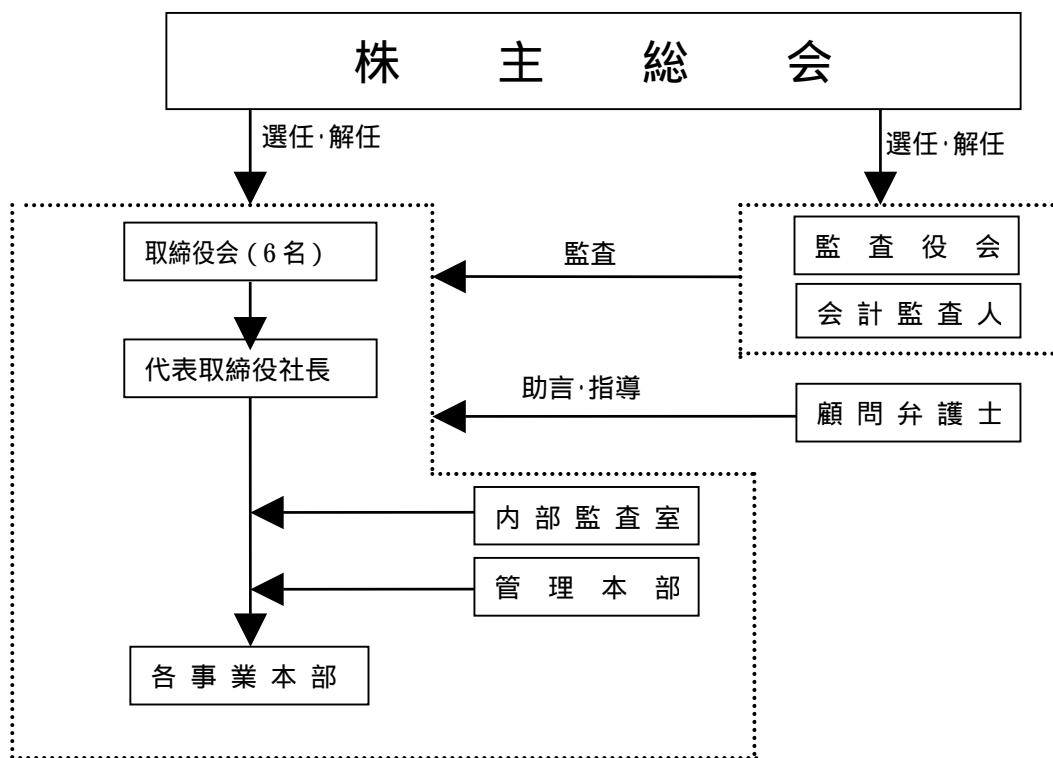
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係の概要

社外監査役のうち中野淑夫氏は、当社の顧問会計士です。木村隆之氏及び藤岡孝雄氏と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社では社外取締役は任命されておりません。

c. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

当社では月1回の定例取締役会の開催に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項等について迅速に協議・決議を行っております。業務執行の監視・監督機能をより一層強化するため、平成16年10月より監査役を1名増員、監査役は、取締役会およびその他重要な会議に出席し、取締役等からの報告を受けるとともに、定期的な業務監査を実施しております。

業務執行と内部統制図



(8) 親会社等に関する事項

当社は親会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

(9) 内部管理体制の整備・運用状況

(内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の状況)

当社の内部管理体制は、社長直轄の内部監査室と管理本部内に経営企画室、経理部、総務部があり、重要な社内情報は必ず管理本部に報告させることにより各業務部門に対する内部牽制が機能するように運営されております。また、社内規定は総務部において、適時整備を実施しております。

(内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況)

平成17年4月1日に「個人情報保護法」が施行されたことに伴い、個人情報保護についての社内体制の構築並びに社員全員に対する教育活動を実施しております。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当中間会計期間のわが国経済は、企業収益の回復に支えられた設備投資意欲の強さと個人消費の堅調さを背景に景気は回復基調に入り、外国人投資家の日本株投資により株式市場も急回復する状況で推移いたしました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましても、デジタル家電関連企業の在庫調整が一巡し設備投資も回復基調に向かいました。

こうした環境の中、これまで研究開発に注力してまいりました半導体の高集積化に大きく期待される三次元実装向けに絶縁膜形成用 CVD 装置の受注が好調となりました。一方、装置の大型化に伴い商談から出荷までの期間が長期化し売上計上が一部下半期にずれ込みました。また、当社の販売の中心分野である LED や LD などの照明用途と光源用途を柱とするオプトエレクトロニクス分野向けの販売は前年同期並でしたが、各種センサー用途やマイクロマシン用途を中心とする電子部品分野向けの販売は在庫調整の影響も受け減少いたしました。海外向けでは、販売台数は前年同期の 12 台を上回る 17 台の出荷があったものの台湾向け青色 LED 製造用途の大型装置を除き中小型装置主体となり、海外売上高比率は前年同期の 19.5% から 14.2% へと低下いたしました。製品開発では、微細化・高精度化が進展するマイクロマシン分野や電子部品分野向けに、独口バート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)導入で開発しましたシリコンディープエッチング(深掘)装置の高速性能化を図りましたが、新製品開発の遅れにより本格的な販売展開は下半期以降となりました。また、前期に引続き三次元実装用の専用機の開発、LED や LD 用途向け次世代 MOCVD 装置の開発など成長分野に的を絞った積極的な研究開発活動を推進いたしました。一方、重要商談については、個々のプロセス開発にも積極的に取り組みました。既存装置については、仕様の見直し、設計の標準化による製造原価のコスト削減に注力いたしました。

以上のような活動をしてまいりましたが、当中間会計期間の売上高は 1,446,028 千円(前年同期比 6.2%減)となりました。経常利益は 89,685 千円(前年同期比 20.4%減)、中間純利益は 50,428 千円(前年同期比 28.8%減)となりました。

(CVD 装置)

三次元実装用や各種センサー用の絶縁膜形成用途で大型 CVD 装置の受注が獲得できましたが、販売台数は前年同期並みの 11 台で上半期の売上高は 407,681 千円(前年同期比 1.3%減)と微減となりました。下半期は、引続き三次元実装用途向けの出荷が期待されます。

(エッチング装置)

オプトエレクトロニクス分野で LED 用途向けに需要が一部回復、生産用途では海外向けに半導体回路の欠陥解析用で引続き受注が獲得できましたが、電子部品向けの需要が減少いたしました。その結果、上半期の売上高は 663,705 千円(前年同期比 8.1%減)となりました。

(洗浄装置)

青色 LED 実装前のクリーニング用途を中心に表示デバイスの表面処理用途等で幅広い需要がありましたが、価格競争の影響から販売は伸び悩み、上半期の売上高は 178,466 千円(前年同期比 12.5%減)となりました。

(その他装置)

当中間会計期間の売上はありません。

(その他)

既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が比較的安定的に推移し、売上高は 196,175 千円(前年同期比 3.4%減)となりました。

(品目別売上高)

品 目	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
CVD装置	407,681	28.2	1.3
エッチング装置	663,705	45.9	8.1
洗浄装置	178,466	12.3	12.5
その他装置	-	-	-
その他	196,175	13.6	3.4
合計	1,446,028	100.0	6.2

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・LD関連のオプトエレクトロニクス分野、各種センサー・磁気ヘッド・水晶デバイス・高周波デバイス等の電子部品分野、有機EL等の表示デバイス分野、半導体パッケージ技術や表面洗浄技術等の実装・表面処理分野、その他分野、部品・メンテナンスに分類しており、その売上構成は次の通りであります。

(用途別売上高)

用 途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	449,335	31.1	5.4
電子部品分野	312,268	21.6	48.5
表示デバイス分野	107,434	7.4	4.9
実装・表面処理分野	253,400	17.5	347.3
その他分野	127,414	8.8	29.1
部品・メンテナンス	196,175	13.6	3.4
合計	1,446,028	100.0	6.2

(2) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、上半期より持ち越しとなっていた三次元実装向け大型装置が売上計上されるのを始め、引続き高速性能が更に向上したボッシュプロセス搭載のエッチング装置とCVD装置の前記市場へのセット販売が期待できます。更に通信分野での需要の回復や海外を含めLEDやLD用途での高密度プラズマエッチング装置の販売も引続き期待されます。また、電子部品分野では携帯電話、各種センサー、マイクロマシンなどの小型化、高機能化のニーズに応える装置の受注が見込めます。研究開発用途向け装置は大学・研究機関への販売回復に加え、基礎研究分野への積極投資にかかわる需要もあり、順調な増加を予想しています。洗浄装置につきましては、新型機種を投入し北米・東南アジアを中心に販売を強化いたします。売上総利益率は海外市場における競争激化が予想されるものの、部品仕入れから一貫した原価低減と装置・部品の標準化の推進等により一層の向上を図ります。一方、販売費及び一般管理費は研究開発および中途採用人材に関する人件費の増加は見込まれますが、コスト削減活動の強化により固定費の増加要因は限定的と見られ、対売上高比率は低下できるものと予想されます。

以上の見通しにより、売上高は3,520百万円(前年同期比13.9%増)、経常利益は430百万円(前年同期比62.9%増)、当期純利益は260百万円(前年同期比56.6%増)となる見込みであります。

(3) 財政状態

(流動資産)

当中間会計期間末における流動資産は、3,682百万円で前中間会計期間末に比べ32百万円増加いたしました。現金及び預金が169百万円減少した一方、売掛金が243百万円増加しました。たな卸資産は40百万円減少いたしました。

(固定資産)

当中間会計期間末における固定資産の残高は、3,228百万円で前中間会計期間末に比べ59百万円減少しました。主な減少要因は、建物の減価償却によるものであります。

(流動負債)

当中間会計期間末における流動負債の残高は、1,436百万円で前中間会計期間末に比べ81百万円減少しました。短期借入金が50百万円増加する一方、一年以内返済予定長期借入金が92百万円減少い

たしました。

(固定負債)

当中間会計期間末における固定負債の残高は、438百万円で前中間会計期間末に比べ25百万円減少しました。長期借入金が47百万円減少し、役員退職慰労引当金は12百万円増加いたしました。

(資本)

当中間会計期間末における資本の残高は、5,037百万円で前中間会計期間末に比べ79百万円増加しました。これは、利益剰余金が84百万円増加したことなどによります。自己資本比率は前年同期比1.4ポイント上昇し、72.9%となりました。

(4) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は税引前中間純利益が89,685千円(前年同期比20.4%減)となり、仕入債務が126,700千円増加したものの、売上債権が332,303千円、たな卸資産が101,402千円増加し、借入金の返済67,540千円(うち短期借入金純増加額249千円、長期借入金減少額67,790千円)などにより、資金残高は前期末に比べ351,792千円減少し、当中間会計期間末には770,505千円(前年同期比20.3%減)となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は206,625千円(前年同期に使用した資金21,333千円)となりました。これは主に税引前中間純利益の89,685千円(前年同期比20.4%減)と仕入債務の増加126,700千円がプラスに寄与した一方、売上債権が332,303千円、たな卸資産が101,402千円増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は23,135千円(前年同期比4.2%減)となりました。その主な内容は定期預金の払戻による収入976,179千円に対して預入による支出が989,717千円、有形固定資産の取得による支出が8,114千円であったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は128,654千円(前年同期比11.9%減)となりました。これは、短期借入金の純増加額249千円に対して、長期借入金の返済による支出67,790千円と配当金の支払61,114千円によるものです。

(5) 事業等のリスク

設備投資動向の影響について

当社の外部環境要因として、半導体製造業界の設備投資動向の影響があります。当社が参画する市場は、主に化合物半導体を用いたLEDや半導体レーザー用途のオプトエレクトロニクス分野や各種センサーやマイクロマシン用途の電子部品分野が中心ですが、シリコン半導体の分野で急激な市場の変化(所謂シリコンサイクル)が起きた場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

新製品開発リスクについて

当社の装置は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置が中心ですが、市場としては従来の研究開発用途に加え生産用途向けに注力しております。微細化・高精度化・高速化が進展する中で、他社製品に比し優位性ある新製品をタイムリーに適正な価格で市場に投入できなければ、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

人材の確保と育成について

当社の将来の成長を可能とする高度なスキルを有する管理者、技術者、営業担当者、メンテナンス要員の確保と育成は極めて重要であり、中途採用によるスキル保有人材の確保と既存社員の教育を体系的・継続的に実施する必要がありますが、計画通りに進まない場合には、当社の将来の成長と業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

製造物責任について

当社が提供する製品は、厳しい品質管理のもとに設計・製造されておりますが、万一顧客に深刻な損失をもたらした場合には損失に対する責任を問われる可能性があります。さらに、これらの問題による当社の企業イメージの低下は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

知的財産権について

当社は、他社製品との差別化を図るため様々な技術やノウハウを開発しており、その技術やノウハウが第三者の特許権その他の知的財産権を侵害しないよう厳重に管理しております。しかし、既に多くの特許権その他の知的財産権が存在し、日々新しい特許権その他の知的財産権が次々と取得される中で、見解の相違等により第三者から特許権侵害等で提訴される可能性があります。また、当社の事業展開に必要な技術についてライセンスを取得できなかった場合には、当社の事業は悪影響を受ける可能性があります。